

晶片構裝介紹與模擬量測技術

課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 構裝基礎知識與發展趨勢 <ul style="list-style-type: none"> Leadframe構裝結構與設計 壓合及增層有機基板構裝結構與設計 應用於構裝基板設計之微波基礎電路設計理論 運用於構裝之量測與模擬技術 <ul style="list-style-type: none"> 電路模擬與電磁模擬技術介紹 頻域網路分析量測校正與適用於構裝之萃取技術 時域量測技術與轉換 積體電路構裝電路設計與分析技術 <ul style="list-style-type: none"> 構裝線路特性阻抗設計與控制 基板線路佈線與寄生效應模擬 高頻特性分析技術，包含Single-end及Mixed-mode S-parameters轉換 系統構裝量測與模擬分析整合、電源完整性分析(SI)與訊號完整性分析(PI)
講 師	<p>吳松茂 老師</p> <p>學歷：國立中山大學 電機工程研究所電波組 博士</p> <p>經歷：日月光集團研發處電性實驗室 部副理、經濟部「兩兆雙星」計畫 封測領域教師與認證命題委員</p> <p>專長：高頻電路系統量測與模擬分析、射頻積體電路(RFIC)封裝電路設計與主被動元件模型化萃取、模組與系統化構裝(SiP)結構設計與其訊號完整性(Signal Integrity)分析、前瞻系統封裝技術開發與封裝設計智財 IP 發展</p>
主辦單位	財團法人車輛研究測試中心、台灣區電機電子工業同業公會
上課時間	100/9/22 (四) 09:30~16:30；共 6 小時
上課地點	台北市內湖區民權東路六段 109 號 7 樓(台灣區電機電子工業同業公會)
課程費用	3,000 元/人(含稅、講義、餐食等費用)
連 絡 人	車輛中心：何小姐 04 – 7811222#2330 電電公會：陳先生 02 – 87926666#218
優惠方案	<p>1. 個人報名者於 9/15 前完成報名繳費者 9 折優惠，同公司二人報名不限時 9 折優惠，同公司三人以上報名不限時 8 折優惠。</p> <p>2. 電電公會會員，適用電電公會優惠折扣辦法。</p>
繳款資訊	<p>1.匯款/ATM 轉帳： 銀行：台灣銀行鹿港分行(004) 戶名：【財團法人車輛研究測試中心】帳號：14300403032-5</p> <p>2.支票/郵政匯票： 抬頭【財團法人車輛研究測試中心】；掛號寄至：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工南七路六號車輛研究測試中心 知識推廣課收</p> <p>3.轉匯款項後，請傳真轉帳證明並附註「課程名稱、上課日期、學員姓名、發票抬頭」傳真：04-7811456 並來電通知承辦人：04-7811222#2330(何小姐) / #5213(郭小姐)</p>

-----報名表-----

「晶片構裝介紹與模擬量測技術」報名表

課程聯絡窗口					
姓 名	聯絡電話	E-mail			
報名學員					
姓 名	部 門	職 稱	E-mail	素食	折價序號
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
公司名稱	發票抬頭		<input type="checkbox"/> 同公司名稱		
統一編號	發票型式		<input type="checkbox"/> 二聯式 <input type="checkbox"/> 三聯式		



公車路線：

1. 內湖行政中心站:0 東、214、214 直、278、286、521、551、617、630、645、645 副、652、903、棕 1、紅 29、紅 32、藍 27、藍 27、市府專車大直內湖線
2. 湖興站:240、240 直、256、28、284、284(直行)、551、小 3、棕 9、棕 1、藍 20、藍 36
3. 國防醫學院中心站:0 東、214、214 直、240、240 直、256、278、28、284、286、521、551、617、630、645、645 副、652、903、小 3、紅 29、藍 20、藍 27、市府專車大直內湖線

捷運路線：

搭乘捷運藍線(南港-永寧線)往南港方向至昆陽站下車，出站後步行 越過忠孝東路，搭乘往內湖方向的公車-小 3、藍 20、藍 36、284、551 至湖興站(第 5 站)下車。